

## 上海韦尔半导体股份有限公司

### 关于增加公司 2018 年度银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 22 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》，同意根据公司经营战略及资金状况，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度（包含固定资产作为抵押物的贷款）。授信额度总额共计人民币 10 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。

鉴于公司 2018 年业绩增长情况及公司经营战略情况，目前的银行综合授信额度不足以满足公司需求，公司于 2018 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司 2018 年度银行综合授信额度的议案》，公司拟在前述授信额度基础上增加银行授信 16 亿元，合计授信额度 26 亿元。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长或总经理在银行综合授信贷款额度累计人民币 26 亿元以内对外签署银行借款相关合同，并全权负责上述授信额度范围内单笔融资的审批相关事宜，不需逐项提请公司董事会审批。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日